Ширина линии фотолюминесценции от самоформирующихся островков Ge(Si), заключенных между напряженными Si-слоями

© М.В. Шалеев^{†¶}, А.В. Новиков^{†*}, Н.А. Байдакова^{†*}, А.Н. Яблонский[†], О.А. Кузнецов[‡], Д.Н. Лобанов[†], З.Ф. Красильник[†]

[†] Институт физики микроструктур Российской академии наук,

603950 ГСП-105 Нижний Новгород, Россия

* Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,

603950 Нижний Новгород, Россия

[‡] Научно-исследовательский физико-технический институт

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,

603950 Нижний Новгород, Россия

(Получена 8 июня 2010 г. Принята к печати 22 июня 2010 г.)

Исследовано влияние толщин напряженных Si-слоев, температуры измерения и мощности оптического возбуждения на ширину пика фотолюминесценции от самоформирующихся наноостровков Ge(Si), выращенных на релаксированных буферных слоях SiGe/Si (001) и заключенных между напряженными Si-слоями. Показано, что путем изменения толщин напряженных Si-слоев над и под островками можно как уменьшать, так и увеличивать ширину линии фотолюминесценции островков Ge(Si). За счет учета диффузионного размытия напряженного слоя Si над островками достигнуто уменьшение ширины пика фотолюминесценции от островков Ge(Si) до значений, сравнимых с шириной пика фотолюминесценции от структур с квантовыми точками на основе прямозонных полупроводников InAs/GaAs.

1. Введение

Интерес к структурам с самоформирующимися наноостровками Ge (Si) связан как с изучением фундаментальных физических явлений, проявляющихся в низкоразмерных системах, так и с возможностью применения таких структур в полупроводниковых приборах [1-3]. Практический интерес к структурам с островками Ge(Si) во многом вызван наблюдаемым от них вплоть до комнатной температуры сигналом люминесценции в области длин волн 1.3-1.7 мкм, которая используется для передачи данных в оптоволоконных линиях связи [4,5]. Фундаментальные исследования люминесценции островков Ge(Si) направлены на выявление особенностей излучательной рекомбинации носителей заряда в наноструктурах на основе непрямозонных полупроводников, в частности влияния пространственной локализации носителей заряда на их рекомбинацию [6,7]. В структурах с островками Ge(Si), выращенными на подложках Si (001), из-за наличия гетероперехода II рода эффективная пространственная локализация возможна только для дырок в островках, а электроны оказываются лишь слабо локализованными в Si на масштабах порядка нескольких высот островка [6,8]. Более эффективная пространственная локализаци носителей заряда обоих знаков может быть обеспечена в структурах с островками Ge(Si), выращенными на релаксированных буферных слоях SiGe/Si (001) и заключенными между напряженными (растянутыми) слоями Si [9-11] (рис. 1). Напряженные слои Si над и под островками в данном классе структур являются потенциальными ямами для электронов, а островки Ge(Si) — для дырок [9,10]

(рис. 1, *b*). Было обнаружено увеличение интенсивности сигнала фотолюминесценции (ФЛ) от островков Ge(Si), встроенных в напряженные слои Si (sSi) (далее островки Ge(Si)/sSi), и уменьшение его ширины по сравнению с сигналом ФЛ от островков Ge(Si), выращенных непосредственно на подложках Si (001) (далее островки Ge(Si)/Si (001)) [9,10]. Оба этих факта связывались с эффективной локализацией электронов в тонких слоях sSi на гетерогранице с островками Ge(Si)/sSi, что приводит к росту неопределенности координаты электронов в импульсном пространстве и, как следствие, к увеличению вероятности излучательной рекомбинации носителей заряда без участия фонона [10,11].

В настоящей работе подробно исследовано влияние параметров напряженных Si-слоев над и под островками Ge(Si) на ширину и положение линии ФЛ от гетероструктур с островками Ge(Si)/sSi.

2. Методика эксперимента

Исследованные структуры с островками Ge(Si)/sSi были выращены методом молекулярно-пучковой эпитаксии. В качестве подложек использовались релаксированные буферные слои Si_{1-x}Ge_x/Si (001) ($x \approx 25\%$) с малой шероховатостью поверхности [12]. Структуры были выращены при 650°С и состояли из ненапряженного слоя SiGe, слоя sSi толщиной $d_1 = 1-3$ нм, на который осаждался слой Ge с эквивалентной толщиной 11-12 монослоев (1 монослой ≈ 0.14 нм $\approx 6.8 \cdot 10^{14}$ атомов/см²) (рис 1, *a*). Согласно ранее проведенным с помощью атомно-силовой микроскопии исследованиям роста островков Ge(Si)/sSi, при данных условиях (доле Ge в буфере, температуре роста, толщине d_1 и количестве

[¶] E-mail: shaleev@ipm.sci-nnov.ru



Рис. 1. a — схематичное изображение попереченого сечения гетероструктур с островками Ge(Si)/sSi; d_1 и d_2 — толщины слоев sSi под и над островками соответственно. b — зонная диаграмма структур с островками Ge(Si)/sSi; стрелками показаны непрямые в реальном пространстве оптические переходы на верхней и нижней гетерограницах островка.

осажденного Ge) на поверхности структур формируется массив куполообразных островков, с разбросом островков по размерам менее 10% [13,14]. При этом для диапазона толщин $d_1 = 1-3$ нм форма и размеры островков Ge(Si) не зависят от толщины слоя sSi под островками [13]. Для люминесцентных исследований островки заращивались еще одним слоем sSi толщиной d_2 и ненапряженным слоем SiGe толщиной 80 нм. Схематическое изображение исследованных структур представлено на рис. 1, *а*. Более подробно методика выращивания островков Ge(Si)/sSi описана в [13].

Измерения спектров ФЛ структур выполнены на монохроматоре ACTON 2300i. Сигнал ФЛ регистрировался с помощью диодной InGaAs-линейки OMA-V. Для возбуждения сигнала ФЛ использовался ультрафиолетовый HeCd-лазер (длина волны излучения $\lambda = 325$ нм). Использование HeCd-лазера, излучение которого имеет малую глубину поглощения в SiGe, позволило избежать присутствия в спектрах ФЛ сигнала от дислокаций, расположенных в дефектных областях в глубине релаксированных буферных слоев SiGe/Si(001)[9].

3. Результаты и их обсуждение

Типичная ширина сигнала ФЛ на его полувысоте от островков Ge(Si)/Si(001) составляет FWHM = 70-100 мэB [2,3,6,15]. Такая большая ширина сигнала

ФЛ в различных работах связывается с разбросом островков по размерам [16], форме [17] и (или) присутствием в сигнале ФЛ от островков Ge(Si)/Si(001) как линии, связанной с излучательной рекомбинацией носителей заряда без участия фонона, так и линий, связанных с рекомбинацией носителей заряда с участием фононов [6,18]. Исследования спектров ФЛ структур с островками Ge(Si)/sSi, в которых номинальные толщины слоев sSi (количество осажденного Si) над и под островками были одинаковы $(d_1 = d_2)$, показали, что при 77 К ширина пика ФЛ от островков Ge(Si)/sSi лежит в диапазоне FWHM = 50-55 мэВ (рис. 2), что заметно меньше ширины пика ФЛ от островков Ge(Si)/Si (001) [9]. Уменьшение ширины пика ФЛ в структурах с островками Ge(Si)/sSi нельзя связать с их малым (< 10%) разбросом по размерам, так как в структурах с островками Ge(Si)/Si(001), имеющих такой же разброс по размерам, ширина пика ФЛ превосходит 70 мэВ [16,17].

Значительное уменьшение ширины пика ФЛ от островков Ge(Si)/sSi по сравнению с пиком ФЛ от островков Ge(Si)/Si(001) связывается с преобладанием в сигнале ФЛ в первом случае только одного пика — возникающего в результате рекомбинации носителей заряда без участия фонона [9]. Если бы наряду с рекомбинацией носителей заряда без участия фононов имела место их рекомбинация с участием оптических фононов и пики, связанные с этими переходами, не были бы спектрально разрешены, суммарная ширина пика ФЛ от островков Ge(Si)/sSi должна была бы быть заметно больше характерных энергий оптических фононов в Si (58 мэВ) и SiGe (49 мэВ) [19], чего не наблюдается в эксперименте. Увеличение вклада бесфононного пика в общий сигнал ФЛ от островков Ge(Si)/sSi происходит за счет эффективной пространственной локализации электронов в тонких слоях sSi $(d_1, d_2 < 3 \text{ нм})$ на гетерогранице с островком Ge(Si) (рис. 1, *b*). Из соотношения неопределенностей



Рис. 2. Спектры фотолюминесценции (PL) структур с островками Ge(Si)/sSi с номинально одинаковыми толщинами слоев sSi над и под островками. $d_1 = d_2 = 1.0$ (1), 1.5 (2), 2 (3) и 3 нм (4). Указана ширина пика на его полувысоте (FWHM). Температура измерений 77 K, мощность оптической накачки 1 мВт.



Рис. 3. Спектры фотолюминесценции (PL) структур с островками Ge(Si)/sSi: $1 - d_1 = d_2 = 1.5$ нм, температура измерений 77 K; $(2,3) - d_1 = 1.5$ нм и $d_2 = 2.3$ нм, температура измерений 77 (2) и 20 K (3). Указана ширина пика на его полувысоте (FWHM). Мощность оптической накачки 1 мВт.

следует, что локализация электронов в реальном пространстве приводит к их делокализации в k-пространстве и соответственно возрастает вероятность их излучательной рекомбинации с дырками без участия фонона. К этому же приводит и рассеяние на гетерограницах электронов, локализованных в слоях sSi. Возрастание интенсивности пика ФЛ, соответствующего излучательной рекомбинации носителей заряда без участия фонона, ранее наблюдалось для SiGe-гетероструктур, выращенных на релаксированных буферных слоях SiGe/Si(001) и состоящих из чередующихся тонких напряженных слоев Ge и Si [20].

В структурах с номинально одинаковыми толщинами слоев sSi над и под островками $(d_1 = d_2)$ увеличение толщин sSi-слоев приводит к сдвигу пика ФЛ в область меньших энергий (рис. 2). Данный сдвиг вызван увеличением глубины потенциальной ямы для электронов в слоях sSi при увеличении их толщины и, как следствие, уменьшением энергии непрямого в реальном пространстве излучательного перехода между электронами в слоях sSi и дырками в островках Ge(Si) [10] (рис. 1, *b*). В структурах с $d_1 = d_2$ ширина пика ФЛ от островков слабо зависит от толщины слоев sSi (рис. 2), что указывает на доминирование в сигнале ФЛ от островков Ge(Si)/sSi пика, связанного с рекомбинацией носителей заряда без участия фононов, в диапазоне толщин слоев sSi $d_1 = d_2 = 1-3$ нм.

Суммарный сигнал ФЛ от островков Ge(Si), заключенных между тонкими слоями напряженного Si, складывается из пиков, связанных с рекомбинацией без участия фононов носителей заряда на верхней и нижней гетерограницах островка (рис.1, b). Очевидно, что минимальная ширина суммарного пика ФЛ будет наблюдаться в том случае, когда положения пиков, вызванных излучательной рекомбинацией электронов (e) из нижнего и

верхнего слоев sSi с дырками (h) из островка, совпадают. Также очевидно, что для совпадения положений этих пиков необходимо совпадение положений электронных уровней в слоях sSi, что выполняется при равенстве реальных толщин напряженных Si-слоев под и над островками. Из-за различных диффузионных процессов реальные толщины слоев sSi над и под островками могут значительно отличаться от номинальных толщин этих слоев (количества осажденного материала). В частности, в структурах с номинально одинаковыми толщинами слоев sSi над и под островками $(d_1 = d_2)$ реальная их толщина может различаться за счет большего диффузионного размытия верхнего слоя sSi. Это предположение обосновано наблюдаемым в структурах с островками Ge(Si) существенным растворением островков при их заращивании Si при температурах больше 400°C [16], которое связывается с неоднородными упругими напряжениями от островков. Согласно результатам исследования структур с островками Ge(Si)/sSi с помощью просвечивающей электронной микроскопии, подобные процессы наблюдаются и при заращивании островков Ge(Si)/sSi слоем напряженного Si. В этом случае покровный слой sSi за счет больших упругих напряжений, присутствующих после формирования островков Ge(Si), размывается сильнее (становится тоньше), чем слой sSi под островками. Таким образом, для структур с номинально одинаковыми (по количеству осажденного материала) слоями sSi существует разница в реальных толщинах слоев sSi над и под островками. Данная разница в толщинах слоев sSi приводит к различию в положении энергетических уровней электронов в них (рис. 1, b) и, как следствие, к разнице в положении пиков ФЛ, связанных с рекомбинацией носителей заряда на верхней и нижней гетерограницах островка. Результатом такого различия является увеличение ширины суммарного сигнала ФЛ, связанного с островками Ge(Si)/sSi. Небольшое увеличение номинальной толщины верхнего слоя sSi по сравнению с нижним слоем sSi позволяет компенсировать различие в реальных толщинах этих слоев. В результате уменьшается разница в положении энергетических уровней электронов в слоях sSi над и под островками, что ведет к заметному уменьшению ширины пика ФЛ от островков Ge(Si)/sSi (рис. 3). Так, в структурах со слоем sSi под островками толщиной $d_1 = 1.5$ нм увеличение толщины покровного слоя sSi с $d_2 = 1.5$ до 2.3 нм приводит к уменьшению ширины сигнала $\Phi \Pi$ от островков Ge(Si)/sSi с FWHM = 55 до 45 мэВ (спектры 1 и 2 на рис. 3).

На рис. 4 представлена зависимость ширины линии $\Phi \Pi$ островков Ge(Si)/sSi при 77 K от разницы между номинальными толщинами напряженных Si-слоев над и под островками $\Delta_{sSi} = d_2 - d_1$. Из приведенных данных видно, что при используемых условиях роста наименьшая ширина линии $\Phi \Pi$ от структур с островками Ge(Si)/sSi наблюдается при $\Delta_{sSi} = 0.6 - 0.8$ нм. Можно предположить, что эта величина соответствует уменьшению толщины покровного слоя sSi в результате его диффузион-



Рис. 4. Зависимость ширины линии фотолюминесценции островков Ge(Si)/sSi на ее полувысоте от разницы между номинальными толщинами слоев sSi над и под островками (Δ_{sSi}) для температуры 77 K и мощности оптической накачки 1 мВт.



Рис. 5. Зависимости ширины пика фотолюминесценции островков Ge(Si)/sSi на его полувысоте (FWHM) структуры с $d_1 = 1.5$ нм и $d_2 = 2.3$ нм от мощности оптической накачки при 77 (1) и 20 K (2). Линии проведены на глаз.

ного перемешивания с островками. Как отмечалось выше, при номинальном равенстве толщин слоев sSi над и под островками ($\Delta_{sSi} = 0$) пик ФЛ уширен относительно минимальных значений, а при $\Delta_{sSi} < 0$ происходит дальнейшее уширение суммарного сигнала ФЛ от островков Ge(Si)/sSi. Ранее было показано, что при осаждении слоя sSi под островками значительно большей толщины, чем над островками, ширина сигнала ФЛ от островков Ge(Si)/sSi увеличивается значительно [10]. Так, для структуры с $d_1 = 3$ нм и $d_2 = 2$ нм при 77 К ширина пика достигает FWHM = 90 мэВ (рис. 4). При этом в сигнале ФЛ уже легко можно выделить отдельные пики, связанные с рекомбинацией электронов из слоев sSi над и под островками [10]. Уширение пика ФЛ островков Ge(Si)/sSi наблюдается и при значениях $\Delta_{sSi} > 0.8$ нм, когда реальная толщина верхнего слоя sSi становится больше, чем нижнего.

Уменьшение ширины пика ФЛ от островков Ge(Si)/sSi может быть достигнуто за счет понижения температуры измерения. Так, в результате уменьшения температуры измерения с 77 до 20 К ширина пика ФЛ от островков Ge(Si)/sSi в структуре с $d_1 = 1.5$ нм и $d_2 = 2.3$ нм уменьшается с FWHM = 45 до 30 мэВ (спектры 2 и 3 на рис. 3). Данное уменьшение ширины пика ФЛ связано с уменьшением заселенности носителями заряда верхних энергетических состояний в островках Ge(Si) и слоях sSi.

Однако уменьшение ширины пика ФЛ островков Ge(Si)/sSi может быть достигнуто и при 77 К за счет уменьшения мощности оптического возбуждения. На рис. 5 приведена зависимость ширины пика ФЛ на его полувысоте от мощности возбуждающего излучения для структуры с $d_1 = 1.5$ нм и $d_2 = 2.3$ нм. Уменьшение мощности возбуждения на порядок (с 1.1 до 0.07 мВт) позволяет для данной структуры уменьшить ширину линии $\Phi \Pi$ при 77 K с FWHM = 43 до 35 мэВ. При этом при уменьшении мощности оптического возбуждения максимум пика ФЛ смещается в область меньших энергий. Подобная зависимость от мощности оптической накачки сигнала ФЛ от островков (уменьшение ширины пика ФЛ и сдвиг его в сторону меньших энергий) наблюдается и в структурах с островками Ge(Si)/Si(001) [21,22]. Такое поведение сигнала ФЛ является типичным для структур с непрямыми в реальном пространстве оптическими переходами (переходами II типа) [23] и связывается с изгибом энергетических зон, вызванным кулоновским потенциалом дырок, локализованных в островках. Уменьшение ширины сигнала ФЛ от островков Ge(Si)/sSi с уменьшением мощности оптической накачки наблюдается и при низких температурах измерения (рис. 5). При температуре 20К при малых мощностях накачки ширина линии ФЛ островков Ge(Si)/sSi для структуры с $d_1 = 1.5$ нм и $d_2 = 2.3$ нм составляет FWHM = 25 мэB (рис. 5). По мнению авторов, достигнутые значения ширины суммарного сигнала ФЛ от островков Ge(Si)/sSi FWHM = 25-30 мэВ являются наименьшими из наблюдаемых ранее для структур с самоформирующимися наноостровками Ge(Si). Полученные значения FWHM = 25-30 мэВ для сигнала ФЛ от островков Ge(Si)/sSi сравнимы с шириной пика ФЛ для структур с квантовыми точками на основе прямозонных полупроводников InAs/GaAs [24].

4. Заключение

В работе исследовано влияние толщин напряженных Si-слоев, между которыми заключены островки Ge(Si), на ширину сигнала ФЛ от структур с островками Ge(Si), выращенными на релаксированных буферных слоях SiGe/Si(001). Меньшая ширина пика ФЛ в исследованных структурах по сравнению с сигналом ФЛ от структур с островками Ge(Si), выращенными непосредственно на подложках Si(001), связывается со значительным увеличением вклада в сигнал ФЛ оптических переходов без участия фононов, которое вызвано локализацией электронов в тонких (толщиной ≤ 3 нм) напряженных Si-слоях над и под островками. Показано, что путем изменения толщин напряженных Si-слоев над и под островками можно менять положение и ширину линии ФЛ островков Ge(Si), заключенных между напряженными Si-слоями. За счет учета диффузионного размытия напряженного слоя Si над островками достигнуто уменьшение ширины пика ФЛ от островков Ge(Si) до значений, сравнимых с шириной пика ФЛ от структур с квантовыми точками на основе прямозонных полупроводников InAs/GaAs.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 08-02-00888-а), Рособразования (проект 2.1.1/617), программ РАН и CRDF (грант программы BRHE № Y5-P-01-07), гранта президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых (грант № MK-7694.2010.2).

Список литературы

- [1] D.J. Paul. Semicond. Sci. Technol., **19**(10), R75 (2004).
- [2] K. Brunner. Rep. Progr. Phys., 65 (1), 27 (2001).
- [3] J. Stangl, V. Holý, G. Bauer. Rev. Mod. Phys., **76** (3), 725 (2004).
- [4] L. Vescan, T. Stoica. J. Luminesc., 80, 485 (1998).
- [5] T. Brunhes, P. Boucaud, S. Sauvage, F. Aniel, J.-M. Lourtioz, C. Hernandez, Y. Campidelli, O. Kermarrec, D. Bensahel, G. Faini, I. Sagnes. Appl. Phys. Lett., 77 (12) 1822 (2000).
- [6] В.Я. Алешкин, Н.А. Бекин, Н.Г. Калугин, З.Ф. Красильник, А.В. Новиков, В.В. Постников, Х. Сейрингер. Письма ЖЭТФ, 67 (1), 46 (1998).
- [7] B.V. Kamenev, L. Tsybeskov, J.-M. Baribeau, D.J. Lockwood. Phys. Rev. B, **72** (19), 193 306 (2005).
- [8] A.I. Yakimov, N.P. Stepina, A.V. Dvurechenskii, A.I. Nikiforov, A.V. Nenashev. Semicond. Sci. Technol., 15 (12), 1125 (2000).
- [9] M.V. Shaleev, A.V. Novikov, A.N. Yablonskiy, Y.N. Drozdov, D.N. Lobanov, Z.F. Krasilnik, O.A. Kuznetsov. Appl. Phys. Lett., 88 (1), 011914 (2006).
- [10] A.V. Novikov, M.V. Shaleev, A.N. Yablonskiy, O.A. Kuznetsov, Yu.N. Drozdov, D.N. Lobanov, Z.F. Krasilnik. Semicond. Sci. Technol., 22 (1), S29 (2007).
- [11] M.V. Shaleev, A.V. Novikov, A.N. Yablonskiy, Y.N. Drozdov, D.N. Lobanov, Z.F. Krasilnik, O.A. Kuznetsov. Appl. Phys. Lett., 91 (2), 021916 (2007).
- [12] Н.В. Востоков, Ю.Н. Дроздов, О.А. Кузнецов, З.Ф. Красильник, А.В. Новиков, В.А. Перевозщиков, М.В. Шалеев. ФТТ, 47 (1), 44 (2005).
- [13] М.В. Шалеев, А.В. Новиков, А.Н. Яблонский, О.А. Кузнецов, Ю.Н. Дроздов, З.Ф. Красильник. ФТП, 41 (2), 172 (2007).
- [14] М.В. Шалеев, А.В. Новиков, А.Н. Яблонский, О.А. Кузнецов, Ю.Н. Дроздов, Д.Н. Лобанов, З.Ф. Красильник. ФТП, 41 (11), 1375 (2007).

- [15] D.J. Lockwood, J.-M. Baribeau, B.V. Kamenev, E.-K. Lee, L. Tsybeskov. Semicond. Sci. Technol., 23 (6), 064 003 (2008).
- [16] M. Stoffel, U. Denker, G.S. Kar, H. Sigg, O.G. Schmidt. Appl. Phys. Lett., 83 (14), 2910 (2003).
- [17] V. Yam, V. Le Thanh, Y. Zheng, P. Boucaud, D. Bouchier. Phys. Rev. B, 63 (3), 033 313 (2001).
- [18] J. Wan, Y.H. Luo, Z.M. Jiang, G. Jin, J.L. Liu, K.L. Wang, X.Z. Liao, J. Zou. Appl. Phys. Lett., 79 (13), 1980 (2001).
- [19] J. Weber, M.I. Alonso. Phys. Rev. B, 40, 5683 (1989).
- [20] N. Usami, F. Issiki, D.K. Nayak, Y. Shiraki, S. Fukatsu. Appl. Phys. Lett., 67 (4), 524 (1995).
- [21] P. Boucaud, S. Sauvage, M. Elkurdi, E. Mercier, T. Brunhies, V. Le Thanh, D. Bouchier, O. Kermarrec, Y. Campidelli, D. Bensahell. Phys. Rev. B, 64 (15), 155 310 (2001).
- [22] Н.В. Востоков, Ю.Н. Дроздов, З.Ф. Красильник, Д.Н. Лобанов, А. В. Новиков, А.Н. Яблонский. Изв. РАН. Сер. физ., 67 (2), 159 (2003).
- [23] C.-K. Sun, G. Wang, J.E. Bowers, B. Brar, H.-R. Blank, H. Kroemer, M.H. Pilkuhn. Appl. Phys. Lett., 68 (11), 1543 (1996).
- [24] P. Howe, E.C. Le Ru, E. Clarke, B. Abbey, R. Murray, T.S. Jones, J. Appl. Phys., 95 (6), 2998 (2004).

Редактор Л.В. Шаронова

Line width of photoluminescence from Ge(Si) self-assembled islands embedded between tensile-strained Si layers

M.V. Shaleev[†], A.V. Novikov[†]*, N.A. Baydakova[†]*, A.N. Yablonskiy[†], O.A. Kuznetsov[‡], D.N. Lobanov[†], Z.F. Krasilnik[†]

[†] Institute for Physics of Microstructures, Russian Academy of Sciences,
603950, GSP-105 Nizhny Novgorod, Russia
* Nizhny Novgorod State University,
603950 Nizhny Novgorod, Russia
[‡] Physical-Technical Research Institute,
Nizhny Novgorod State University,
603950 Nizhny Novgorod, Russia

Abstract The effect of stained Si layers thicknesses, measurement temperature and optical pumping power on width of photoluminescence line from Ge(Si) self-assembled islands grown on relaxed SiGe/Si(001) buffer layers and embedded between tensile-stained Si layers was studied. As shown it is possible both to decrease and increase the Ge(Si) islands-related photoluminescence line width by changing the strained Si layers thicknesses under and above the islands. The decrease of Ge(Si) islands-related photoluminescence line width up to values comparable with that from direct band InAs/GaAs quantum dots was achieved with taking into account higher diffusion-induced smearing of strained Si layer above the islands.